

2023-2029年中国IC载板 (封装基板) 行业发展趋势与投资前景报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2023-2029年中国IC载板（封装基板）行业发展趋势与投资前景报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202308/386253.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2023-2029年中国IC载板（封装基板）行业发展趋势与投资前景报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局市场服务行业的重要决策参考依据。

报告目录：

第1章：IC载板行业综述及数据来源说明

1.1 IC载板行业界定

1.1.1 IC载板是芯片封装的核心载体

- 1、半导体制造工艺流程
- 2、封装的定义
- 3、封装的功能
- 4、封装的范围（L0、L1、L2、L3）
- 5、IC载板（IC封装载板/封装基板）的定义
- 6、IC载板的作用

1.1.2 IC载板的术语&概念辨析

- 1、IC载板专业术语说明
- 2、IC载板相关概念辨析
 - （1）IC载板与HDI板
 - （2）IC载板与PCB板

1.1.3 国家标准中的IC载板（定义及行业归属）

1.2 IC载板行业分类

- 1.2.1 封装工艺不同
- 1.2.2 绝缘材料不同
- 1.2.3 封装方式不同
- 1.2.4 封装材料不同
- 1.2.5 应用领域不同

1.3 本报告研究范围界定说明

1.4 IC载板行业市场监管&标准体系

- 1.4.1 IC载板行业监管体系及机构职能（主管部门&行业协会&自律组织）
- 1.4.2 IC载板行业标准体系及建设进程（国家/地方/行业/团体/企业标准）
- 1.4.3 IC载板行业现行&即将实施标准汇总
- 1.4.4 IC载板行业重点标准及其影响解读
- 1.5 本报告数据来源及统计标准说明
- 1.5.1 本报告权威数据来源
- 1.5.2 本报告研究方法及统计标准说明

第2章：全球IC载板行业发展现状及市场趋势洞察

- 2.1 全球IC载板行业标准体系&技术进展
 - 2.1.1 全球IC载板行业标准体系
 - 2.1.2 全球IC载板行业技术进展
- 2.2 全球IC载板行业发展历程&产品演进
 - 2.2.1 全球IC载板行业发展历程
 - 2.2.2 全球IC载板产品演进示意图
- 2.3 全球IC载板行业市场发展现状及竞争
 - 2.3.1 全球IC载板行业市场供需状况
 - 2.3.2 全球IC载板行业细分市场分析（产品/应用等）
 - 2.3.3 全球IC载板企业兼并重组状况
 - 2.3.4 全球IC载板行业市场竞争格局
 - 2.3.5 全球IC载板行业区域发展格局
 - 2.3.6 重点区域：日本IC载板市场分析
- 2.4 全球IC载板行业市场规模体量及前景预判
 - 2.4.1 全球IC载板行业市场规模体量
 - 2.4.2 全球IC载板行业市场前景预测（未来5年预测）
 - 2.4.3 全球IC载板行业发展趋势洞悉
- 2.5 全球IC载板行业发展经验总结和有益借鉴

第3章：中国IC载板行业发展现状及市场痛点解析

- 3.1 中国IC载板行业发展历程分析
- 3.2 中国IC载板行业技术进展研究
 - 3.2.1 IC载板行业科研投入（力度及强度）

3.2.2 IC载板行业科研创新（专利与转化）

3.2.3 IC载板行业关键技术（现状与发展）

- 1、IC基板制作技术
- 2、微孔技术
- 3、图形形成和镀铜技术
- 4、阻焊工艺
- 5、表面处理技术
- 6、检测能力和产品可靠性测试技术

3.2.4 IC载板行业技术路线（工艺与流程）

1、IC载板行业工艺类型/技术路线

- （1）减除法
- （2）全加成法
- （3）半加成法

2、IC载板行业工艺/技术流程图解

3、IC载板行业工艺/技术路线对比

3.3 中国IC载板行业对外贸易状况

3.4 中国IC载板行业市场主体分析

3.4.1 IC载板行业市场主体类型（投资/经营/服务/中介主体）

3.4.2 IC载板行业企业入场方式（自建/并购/战略合作等）

3.4.3 IC载板行业市场主体数量

3.4.4 IC载板注册/在业/存续企业

3.5 中国IC载板行业招投标市场解读

3.5.1 IC载板行业招投标信息汇总

3.5.2 IC载板行业招投标信息解读

3.6 中国IC载板行业市场供给分析

3.6.1 IC载板行业产线布局及扩产计划

3.6.2 IC载板行业市场供给水平（产量）

3.7 中国IC载板行业市场需求分析

3.7.1 IC载板终端用户/行业概述

3.7.2 IC载板市场需求现状分析（需求量）

3.7.3 IC载板市场供需平衡状况（缺口仍较大）

3.7.4 IC载板市场行情走势分析

3.8 中国IC载板行业市场规模体量

3.9 中国IC载板行业市场发展痛点

第4章：中国IC载板行业市场竞争及投资并购状况

4.1 中国IC载板行业市场竞争布局状况

4.1.1 中国IC载板行业竞争者入场进程

4.1.2 中国IC载板行业竞争者省市分布热力图

4.1.3 中国IC载板行业竞争者战略布局状况

4.2 中国IC载板行业市场竞争格局分析

4.2.1 中国IC载板行业企业竞争集群分布

4.2.2 中国IC载板行业企业竞争格局分析

4.2.3 中国IC载板行业市场集中度分析

4.3 中国IC载板全球市场竞争力&国产化/国际化布局

4.4 中国IC载板行业波特五力模型分析

4.4.1 中国IC载板行业供应商的议价能力

4.4.2 中国IC载板行业消费者的议价能力

4.4.3 中国IC载板行业新进入者威胁

4.4.4 中国IC载板行业替代品威胁

4.4.5 中国IC载板行业现有企业竞争

4.4.6 中国IC载板行业竞争状态总结

4.5 中国IC载板行业投融资&并购重组&上市情况

4.5.1 中国IC载板行业投融资状况

4.5.2 中国IC载板行业兼并与重组

4.5.3 中国IC载板行业IPO动态（已上市、申请&被否情况）

第5章：中国IC载板产业链全景及配套产业发展

5.1 中国IC载板产业链——产业结构属性分析

5.1.1 IC载板产业链结构梳理

5.1.2 IC载板产业链生态图谱

5.1.3 IC载板产业链区域热力图

5.2 中国IC载板价值链——产业价值属性分析

5.2.1 IC载板行业成本投入结构

5.2.2 IC载板行业价格传导机制

5.2.3 IC载板行业价值链分析图

5.3 中国IC载板基板材料（基材）市场分析

5.3.1 IC载板基板材料（基材）类型

- 1、硬质基板材料：BT树脂、ABF材料、MIS
- 2、柔性基板材料：聚酰亚胺（PI）、PE
- 3、陶瓷基板材料：氧化铝、氮化铝、碳化硅等陶瓷材料

5.3.2 中国IC载板基板材料（基材）市场现状

5.3.3 中国IC载板基板材料（基材）发展趋势

5.4 中国IC载板用电解铜箔市场分析

5.4.1 IC载板用电解铜箔概述

5.4.2 中国IC载板用电解铜箔市场现状

5.4.3 中国IC载板用电解铜箔发展趋势

5.5 中国IC载板化学品/耗材市场分析

5.5.1 IC载板化学品/耗材类型（干膜、油墨、蚀刻剂、显影剂等）

5.5.2 中国IC载板化学品/耗材市场现状

5.5.3 中国IC载板化学品/耗材需求趋势

5.6 中国IC载板生产加工设备市场分析

5.6.1 中国IC载板生产加工设备类型（曝光、电镀、蚀刻、真空压膜等）

5.6.2 中国IC载板生产加工设备市场现状

5.6.3 中国IC载板生产加工设备需求趋势

5.7 配套产业布局对IC载板行业的影响总结

第6章：中国IC载板行业细分产品市场分析

6.1 中国IC载板行业细分市场概况

6.1.1 中国IC载板行业细分市场对比

6.1.2 中国IC载板行业细分市场结构

6.2 IC载板细分市场：ABF载板（硬质基板）

6.2.1 ABF载板概述

6.2.2 ABF载板市场简析

6.2.3 ABF载板发展趋势

6.3 IC载板细分市场：BT载板（硬质基板）

- 6.3.1 BT载板概述
- 6.3.2 BT载板市场简析
- 6.3.3 BT载板发展趋势
- 6.4 IC载板细分市场：柔性基板
 - 6.4.1 柔性基板概述
 - 6.4.2 柔性基板市场简析
 - 6.4.3 柔性基板发展趋势
- 6.5 IC载板细分市场：陶瓷基板
 - 6.5.1 陶瓷基板概述
 - 6.5.2 陶瓷基板市场简析
 - 6.5.3 陶瓷基板发展趋势
- 6.6 中国IC载板行业细分产品市场战略地位分析

第7章：中国IC载板行业细分市场需求分析

- 7.1 IC载板应用场景扩展&市场领域分布
 - 7.1.1 IC载板应用场景扩展（使用场景&需求场景/消费场景）
 - 1、IC载板市场定位
 - 2、IC载板应用场景
 - 2、IC载板场景扩展
 - 7.1.2 IC载板市场领域分布（应用领域&行业应用&TO B）
 - 1、IC载板市场领域分布
 - 2、IC载板市场渗透概况
- 7.2 中国IC载板细分应用市场分析：存储芯片封装基板（eMMC）
 - 7.2.1 中国存储芯片发展现状
 - 7.2.2 中国存储芯片趋势前景
 - 7.2.3 存储芯片封装基板（eMMC）概述
 - 7.2.4 中国存储芯片封装基板（eMMC）需求现状分析
 - 7.2.5 中国存储芯片封装基板（eMMC）市场潜力分析
- 7.3 中国IC载板细分应用市场分析：微机电系统封装基板（MEMS）
 - 7.3.1 中国MEMS发展现状
 - 7.3.2 中国MEMS趋势前景
 - 7.3.3 微机电系统封装基板（MEMS）概述

- 7.3.4 中国微机电系统封装基板（MEMS）需求现状分析
- 7.3.5 中国微机电系统封装基板（MEMS）市场潜力分析
- 7.4 中国IC载板细分应用市场分析：射频模块封装基板（RF）
 - 7.4.1 中国射频模块发展现状
 - 7.4.2 中国射频模块趋势前景
 - 7.4.3 射频模块封装基板（RF）概述
 - 7.4.4 中国射频模块封装基板（RF）需求现状分析
 - 7.4.5 中国射频模块封装基板（RF）市场潜力分析
- 7.5 中国IC载板细分应用市场分析：处理器芯片封装基板
 - 7.5.1 中国处理器芯片发展现状
 - 7.5.2 中国存处理器芯片趋势前景
 - 7.5.3 处理器芯片封装基板概述
 - 7.5.4 中国处理器芯片封装基板需求现状分析
 - 7.5.5 中国处理器芯片封装基板市场潜力分析
- 7.6 中国IC载板细分应用市场分析：高速通信封装基板
 - 7.6.1 中国高速通信封装基板发展现状
 - 7.6.2 中国高速通信封装基板趋势前景
 - 7.6.3 高速通信封装基板概述
 - 7.6.4 中国高速通信封装基板需求现状分析
 - 7.6.5 中国高速通信封装基板市场潜力分析

第8章：全球及中国IC载板企业布局案例解析

- 8.1 全球及中国IC载板主要企业布局梳理
- 8.2 全球IC载板主要企业布局案例分析（不分先后，可定制）
 - 8.2.1 日本揖斐电株式会社（IBIDEN）
 - 1、企业发展历程&基本信息
 - 2、企业业务架构&经营情况
 - 3、企业IC载板业务布局&发展现状
 - 4、企业IC载板业务销售&在华布局
 - 8.2.2 韩国三星电机（SAMSUNG）
 - 1、企业发展历程&基本信息
 - 2、企业业务架构&经营情况

3、企业IC载板业务布局&发展现状

4、企业IC载板业务销售&在华布局

8.3 中国IC载板主要企业布局案例分析（不分先后，可定制）

8.3.1 欣兴电子股份有限公司

1、企业发展历程&基本信息

2、企业业务架构&经营情况

3、企业IC载板业务布局详情&生产力

4、企业IC载板业务布局比重&竞争力

5、企业IC载板业务布局规划&新动向

6、企业IC载板业务布局战略&优劣势

8.3.2 景硕科技股份有限公司

1、企业发展历程&基本信息

2、企业业务架构&经营情况

3、企业IC载板业务布局详情&生产力

4、企业IC载板业务布局比重&竞争力

5、企业IC载板业务布局规划&新动向

6、企业IC载板业务布局战略&优劣势

8.3.3 南亚电路板股份有限公司

1、企业发展历程&基本信息

2、企业业务架构&经营情况

3、企业IC载板业务布局详情&生产力

4、企业IC载板业务布局比重&竞争力

5、企业IC载板业务布局规划&新动向

6、企业IC载板业务布局战略&优劣势

8.3.4 日月光半导体制造股份有限公司

1、企业发展历程&基本信息

2、企业业务架构&经营情况

3、企业IC载板业务布局详情&生产力

4、企业IC载板业务布局比重&竞争力

5、企业IC载板业务布局规划&新动向

6、企业IC载板业务布局战略&优劣势

8.3.5 深南电路股份有限公司

- 1、企业发展历程&基本信息
 - 2、企业业务架构&经营情况
 - 3、企业IC载板业务布局详情&生产力
 - 4、企业IC载板业务布局比重&竞争力
 - 5、企业IC载板业务布局规划&新动向
 - 6、企业IC载板业务布局战略&优劣势
- 8.3.6 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
- 1、企业发展历程&基本信息
 - 2、企业业务架构&经营情况
 - 3、企业IC载板业务布局详情&生产力
 - 4、企业IC载板业务布局比重&竞争力
 - 5、企业IC载板业务布局规划&新动向
 - 6、企业IC载板业务布局战略&优劣势
- 8.3.7 珠海越亚半导体股份有限公司
- 1、企业发展历程&基本信息
 - 2、企业业务架构&经营情况
 - 3、企业IC载板业务布局详情&生产力
 - 4、企业IC载板业务布局比重&竞争力
 - 5、企业IC载板业务布局规划&新动向
 - 6、企业IC载板业务布局战略&优劣势
- 8.3.8 深圳丹邦科技股份有限公司
- 1、企业发展历程&基本信息
 - 2、企业业务架构&经营情况
 - 3、企业IC载板业务布局详情&生产力
 - 4、企业IC载板业务布局比重&竞争力
 - 5、企业IC载板业务布局规划&新动向
 - 6、企业IC载板业务布局战略&优劣势
- 8.3.9 崇达技术股份有限公司
- 1、企业发展历程&基本信息
 - 2、企业业务架构&经营情况
 - 3、企业IC载板业务布局详情&生产力
 - 4、企业IC载板业务布局比重&竞争力

5、企业IC载板业务布局规划&新动向

6、企业IC载板业务布局战略&优劣势

8.3.10 惠州中京电子科技股份有限公司

1、企业发展历程&基本信息

2、企业业务架构&经营情况

3、企业IC载板业务布局详情&生产力

4、企业IC载板业务布局比重&竞争力

5、企业IC载板业务布局规划&新动向

6、企业IC载板业务布局战略&优劣势

第9章：中国IC载板行业发展环境洞察&SWOT分析

9.1 中国IC载板行业经济（Economy）环境分析

9.1.1 中国宏观经济发展现状

9.1.2 中国宏观经济发展展望

9.1.3 中国IC载板行业发展与宏观经济相关性分析

9.2 中国IC载板行业社会（Society）环境分析

9.2.1 中国IC载板行业社会环境分析

9.2.2 社会环境对IC载板行业发展的影响总结

9.3 中国IC载板行业政策（Policy）环境分析

9.3.1 国家层面IC载板行业政策规划汇总及解读（指导类/支持类/限制类）

1、国家层面IC载板行业政策汇总及解读

2、国家层面IC载板行业规划汇总及解读

9.3.2 31省市IC载板行业政策规划汇总及解读（指导类/支持类/限制类）

1、31省市IC载板行业政策规划汇总

2、31省市IC载板行业发展目标解读

9.3.3 国家重点规划/政策对IC载板行业发展的影响

1、国家“十四五”规划对IC载板行业发展的影响

2、《重点新材料首批次应用示范指导目录》对IC载板行业发展的影响

9.3.4 政策环境对IC载板行业发展的影响总结

9.4 中国IC载板行业SWOT分析（优势/劣势/机会/威胁）

第10章：中国IC载板行业市场前景及发展趋势分析

- 10.1 中国IC载板行业发展潜力评估
- 10.2 中国IC载板行业未来关键增长点分析
- 10.3 中国IC载板行业发展前景预测（未来5年数据预测）
- 10.4 中国IC载板行业发展趋势预判（疫情影响等）

第11章：中国IC载板行业投资战略规划策略及建议

- 11.1 中国IC载板行业进入与退出壁垒
 - 11.1.1 IC载板行业进入壁垒分析
 - 11.1.2 IC载板行业退出壁垒分析
- 11.2 中国IC载板行业投资风险预警
- 11.3 中国IC载板行业投资机会分析
 - 11.3.1 IC载板产业链薄弱环节投资机会
 - 11.3.2 IC载板行业细分领域投资机会
 - 11.3.3 IC载板行业区域市场投资机会
 - 11.3.4 IC载板产业空白点投资机会
- 11.4 中国IC载板行业投资价值评估
- 11.5 中国IC载板行业投资策略与建议

图表目录

- 图表1：IC载板专业术语说明
- 图表2：IC载板相关概念辨析
- 图表3：《国民经济行业分类与代码》中本报告研究行业归属
- 图表4：IC载板的分类
- 图表5：本报告研究范围界定
- 图表6：中国IC载板行业监管体系结构图
- 图表7：中国IC载板行业主管部门&行业协会&自律组织机构职能
- 图表8：IC载板行业标准体系框架&建设进程（国家/地方/行业/团体/企业标准）
- 图表9：中国IC载板行业现行&即将实施标准汇总
- 图表10：中国IC载板行业重点标准及其影响解读
- 图表11：本报告权威数据资料来源汇总
- 图表12：本报告的主要研究方法 & 统计标准说明
- 图表13：全球IC载板行业标准体系&技术进展

图表14：全球IC载板行业发展历程&产品演进

图表15：全球IC载板行业兼并重组状况

图表16：全球IC载板行业市场竞争格局

图表17：全球IC载板行业市场发展现状

图表18：全球IC载板行业供需状况

图表19：全球IC载板行业细分市场分析

图表20：全球IC载板企业兼并重组状况

图表21：全球IC载板行业市场竞争格局

图表22：全球IC载板行业区域发展格局

图表23：全球IC载板行业重点区域市场分析

图表24：全球IC载板行业市场规模体量分析

图表25：全球IC载板行业市场规模体量分析

图表26：全球IC载板行业市场前景预测（未来5年预测）

图表27：全球IC载板行业发展趋势洞悉

图表28：全球IC载板行业发展经验总结和有益借鉴

图表29：中国IC载板行业发展历程

图表30：IC载板行业科研投入状况（研发力度及强度）

图表31：IC载板行业科研投入（力度及强度）

图表32：IC载板行业科研创新（专利与转化）

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202308/386253.html>